

2008年3月期 第3四半期決算に関する補足資料

億円未満は切り捨て表示しています

1. 第3四半期決算概要(2007年10月～2007年12月)  
(連結)

	2007年3月期 第3四半期 2006.10-2006.12	2008年3月期 第3四半期 2007.10-2007.12	増減率
売上高	2,100	1,998	4.9%
営業利益	429	384	10.3%
経常利益	421	397	5.6%
税前利益	421	400	5.0%
当期純利益	269	256	5.1%

単位:億円

	2007年3月期 第1～第3四半期計 2006.4-2006.12	2008年3月期 第1～第3四半期計 2007.4-2007.12	増減率
	6,006	6,762	12.6%
	1,011	1,335	32.0%
	1,003	1,355	35.1%
	1,006	1,382	37.4%
	642	880	37.1%

2. 部門別・地域別 売上高  
(連結)

	2007年3月期 第3四半期 2006.10-2006.12	2008年3月期 第3四半期 2007.10-2007.12	増減率
半導体製造装置			
国内	470	522	11.1%
米国	215	223	3.7%
欧州	122	41	66.0%
韓国	231	155	32.7%
台湾	363	536	47.6%
中国	89	41	53.4%
東南アジア他	95	86	10.0%
海外計	1,118	1,084	3.0%
計	1,588	1,607	1.2%
FPD製造装置			
国内	120	61	49.3%
韓国	38	7	80.0%
台湾	99	18	81.8%
中国・東南アジア他	1	13	827.0%
海外計	139	39	71.9%
計	260	100	61.4%
電子部品・情報通信機器			
国内	230	258	12.1%
海外	19	31	61.4%
計	249	289	15.9%
その他			
国内	2	0	71.2%
海外	-	-	-
計	2	0	71.2%
連結合計			
国内	823	842	2.3%
海外	1,277	1,155	9.5%
計	2,100	1,998	4.9%

単位:億円

	2007年3月期 第1～第3四半期計 2006.4-2006.12	2008年3月期 第1～第3四半期計 2007.4-2007.12	増減率
	1,248	1,468	17.6%
	746	747	0.1%
	368	186	49.5%
	643	567	11.9%
	987	1,955	98.0%
	232	247	6.2%
	199	227	13.9%
	3,178	3,931	23.7%
	4,427	5,399	22.0%
	283	298	5.3%
	129	129	0.2%
	317	74	76.6%
	55	34	38.6%
	502	237	52.6%
	785	536	31.7%
	728	743	2.0%
	56	78	40.4%
	785	822	4.8%
	8	3	60.8%
	-	-	-
	8	3	60.8%
	2,269	2,514	10.8%
	3,737	4,247	13.7%
	6,006	6,762	12.6%

3. 事業の種類別 売上高及び営業利益

	2007年3月期 第3四半期 2006.10-2006.12	2008年3月期 第3四半期 2007.10-2007.12	増減率
産業用電子機器			
売上高	1,856	1,711	7.8%
営業費用	1,433	1,335	6.8%
営業利益	423	375	11.2%
電子部品・ 情報通信機器			
売上高	252	291	15.5%
営業費用	243	282	16.0%
営業利益	9	9	3.7%
消去又は全社			
売上高	8	4	-
営業費用	5	5	-
営業利益	3	0	-
連結			
売上高	2,100	1,998	4.9%
営業費用	1,671	1,613	3.5%
営業利益	429	384	10.3%

単位:億円

	2007年3月期 第1～第3四半期計 2006.4-2006.12	2008年3月期 第1～第3四半期計 2007.4-2007.12	増減率
	5,241	5,947	13.5%
	4,255	4,640	9.0%
	986	1,307	32.5%
	793	830	4.6%
	765	802	4.9%
	28	27	3.3%
	28	15	-
	25	16	-
	3	0	-
	6,006	6,762	12.6%
	4,995	5,427	8.6%
	1,011	1,335	32.0%

4. 受注高  
 (連結)

単位: 億円

	2007年3月期 第3四半期 2006.10-2006.12	2008年3月期 第3四半期 2007.10-2007.12	増減率
半導体製造装置	1,964	1,403	28.6%
FPD製造装置	55	573	933.0%
電子部品・情報通信機器	269	308	14.2%
その他	2	0	71.2%
合計	2,292	2,285	0.3%

	2007年3月期 第1～第3四半期計 2006.4-2006.12	2008年3月期 第1～第3四半期計 2007.4-2007.12	増減率
	5,776	4,058	29.8%
	626	688	9.8%
	820	843	2.9%
	8	3	60.8%
	7,232	5,593	22.7%

5. 受注残高  
 (連結)

単位: 億円

	2007年3月期 第3四半期 2006.12末	2008年3月期 第3四半期 2007.12末	増減率
半導体製造装置	3,841	2,727	29.0%
FPD製造装置	831	803	3.3%
電子部品・情報通信機器	162	162	0.4%
合計	4,835	3,694	23.6%

6. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費  
 (連結)

単位: 億円

	2007年3月期 第3四半期 2006.10-2006.12	2008年3月期 第3四半期 2007.10-2007.12	増減率
設備投資額	93	41	55.5%
減価償却実施額	48	55	14.6%
研究開発費	133	159	19.4%

	2007年3月期 第1～第3四半期計 2006.4-2006.12	2008年3月期 第1～第3四半期計 2007.4-2007.12	増減率
	189	169	10.9%
	136	153	12.5%
	404	478	18.2%

- \* 前下半期より、従来「産業用電子機器」セグメントに区分しておりました「コンピュータ・ネットワーク」を「電子部品」セグメントに区分するとともに、当該セグメントの名称を「電子部品・情報通信機器」に変更しております。なお、2007年3月期第3四半期及び2007年3月期第1～第3四半期計については、変更後の区分により表示しております。
- \* 当社の主力製品である半導体製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。